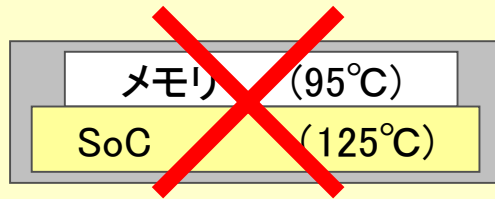


■ 汎用メモリによるSiP

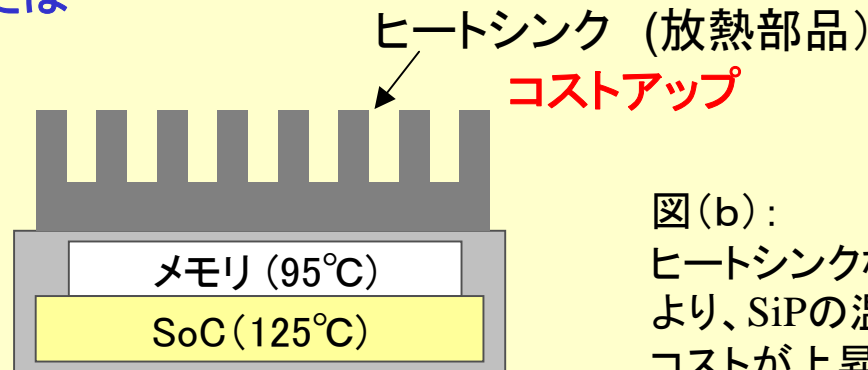


(a) SiPの温度: 105°C

NG

図(a):
SoCの消費電力が大きくSiPの温度が105°Cとなり、メモリの動作温度上限(95°C)を満たせないため、SiPはNGとなります。

または



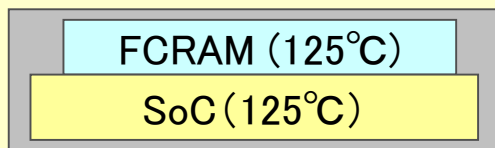
(b) SiPの温度: 90°C

OK

図(b):
ヒートシンクなどの放熱部品を追加することにより、SiPの温度を下げることは可能ですが、コストが上昇します。

*: メモリおよびSoCの()の温度は、動作温度の上限を示す。

■ 125°C動作のFCRAMによるSiP



(c) SiPの温度：105°C
OK

図(c)：
125°C対応のFCRAMを使用することにより、
SiPの温度が105°Cとなっても動作可能です
ので、放熱部品も必要ありません。

*: FCRAMおよびSoCの()の温度は、動作温度の上限を示す。